

Certyfikowany specjalista IPC-7711/7721 (CIS)

Szkolenie certyfikacyjne IPC Program szkolenia

Przeгляд programu szkoleniowego IPC-7711/7721 CIS

Moduł 1-10 (20% - teoria, 80% - praktyka)

Moduł 1 (rozdział 1):

Wprowadzenie / IPC - Zasady i procedury / Procedury wspólne

Czas trwania: ok. 5 godzin

1 Ogólnie

1.1 Zakres

1.2 Cel

1.3 Tło historyczne

1.4 Terminy i Definicje

1.5 Stosowalność, Kontrole i Dopuszczalność

1.6 Szkolenie

1.7 Podstawowe rozważania

1.8 Stacje robocze, Narzędzia, Materiały i Procesy

1.9 Lutowanie bezołowiowe

2.8 Dbłość i utrzymanie grot

Moduł 2 (rozdział 2):

Przewody

Czas trwania: ok. 0,5 godziny – teoria, ok. 2,5 godziny – praktyka

8.1 Splatanie

Moduł 3 (rozdział 3):

Powłoki ochronne

Czas trwania: ok. 0,75 godziny – teoria, ok. 1,25 godziny – praktyka

2.3 Usuwanie warstwy

2.4 Wymiana warstwy

2.5 Suszenie i podgrzewanie

Moduł 4 (rozdział 4):

Komponenty przewlekane

Czas trwania: ok. 0,75 godziny – teoria, ok. 4,5 godziny – praktyka

3.1 Rozlutowywanie komponentów przewlekanych

Moduł 5 (rozdział 5):

Komponenty typu CHIP i MELF

Czas trwania: ok. 0,75 godziny – teoria, ok. 2,5 godziny – praktyka

3.3 Demontaż Komponentu Chip

4 Przygotowanie pól lutowniczych

5.3 Montaż Komponentu Chip

Moduł 6 (rozdział 6):

Komponenty typu skrzydła mowy

Czas trwania: ok. 1 godziny – teoria, ok. 4 godziny – praktyka

3.5 Demontaż Komponentu SOT

3.6 Demontaż Komponentu SOIC (wyprowadzenia z dwóch stron)

3.7 Demontaż Komponentu QFP (wyprowadzenia z czterech stron)

4 Przygotowanie Pól Lutowniczych SMD

5.5 Montaż Komponentu QFP

Moduł 7 (rozdział 7):

Komponenty PLCC (Wyprowadzenia J)

Czas trwania: ok. 0,5 godziny – teoria, ok. 1,5 godziny – praktyka

3.8 Demontaż Komponentu PLCC

4 Przygotowanie Pól Lutowniczych SMD

5.6 Montaż Komponentu PLCC

6 Usuwanie Zwarć

Moduł 8 (rozdział 8):

Komponenty BGA

Czas trwania: ok. 0,5 godziny – teoria

3.9 Demontaż BGA/CSP

5.7 Montaż BGA/CSP

Moduł 9 (rozdział 9):

Naprawy laminatu

Czas trwania: ok. 0,5 godziny – teoria, ok. 1,5 godziny – praktyka

2.6 Żywice Epoksydowe – Miksowanie i Nakładani

3.3 Naprawa otworu

3.5 Naprawa materiału podstawowego

Moduł 10 (rozdział 10):

Naprawy obwodów

Czas trwania: ok. 0,75 godziny – teoria, ok. 2,75 godziny – praktyka

4.2 Naprawa przewodnika

4.7 Naprawa pola montażowego SMD

5.1 Naprawa otworu metalizowanego

6.1 Przewody połączeniowe

2.6 Żywice Epoksydowe – Miksowanie i Nakładanie

Moduł 11 (rozdział 11):

Podstawy trenerskie

Czas trwania: ok. 0,75 godziny - teoria

Egzamin końcowy:

Egzamin końcowy (25 pytań) książka otwarta (OPEN BOOK): ok. 2 godziny

Ramowy plan dzienny szkolenia:

9:00 Rozpoczęcie kursu

10:30 Przerwa Kawowa

10:45 Kontynuacja

12:00 Lunch

13:00 Kontynuacja

14:30 Przerwa kawowa

14:40 Kontynuacja

16:00 Zakończenie sesji

Dzień egzaminacyjny:

Ostatni dzień szkolenia

9:00 Rozpoczęcie testu

10:30 Przerwa kawowa

10:45 Kontynuacja

12:00 Zakończenie szkolenia

**Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie
www.pbtraining.com.pl**